

#### ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

積層構造の複数のプリント配線板の間に空気ギャップを形成して一体化された多層回路板。スルーホール用穿孔を有する金属コアー基板の全表面上に絶縁層が形成され、その上に印刷配線層が形成されている。金属コアー基板に一体的に設けられた金属突起が積層構造の隣接配線板間の接合電極の役目を果たす。隣接配線板間に形成される空気ギャップの幅は金属突起の高さによって決定される。